



2024年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2023年10月11日

上場会社名 ローツェ株式会社 上場取引所 東
コード番号 6323 URL <https://www.rorze.com>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 藤代 祥之
問合せ先責任者 (役職名) 管理部長 (氏名) 伊勢村 英一 (TEL) 084-960-0001
四半期報告書提出予定日 2023年10月16日 配当支払開始予定日 -
四半期決算補足説明資料作成の有無：有
四半期決算説明会開催の有無：有（機関投資家・アナリスト向け）

(百万円未満切捨て)

1. 2024年2月期第2四半期の連結業績（2023年3月1日～2023年8月31日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年2月期第2四半期	40,992	△10.4	9,952	△9.0	13,878	△17.9	9,835	△20.5
2023年2月期第2四半期	45,753	55.1	10,932	63.6	16,901	132.4	12,366	124.9

(注) 包括利益 2024年2月期第2四半期 13,881百万円 (△20.9%) 2023年2月期第2四半期 17,539百万円 (131.2%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年2月期第2四半期	558 24	557 21
2023年2月期第2四半期	715 61	714 27

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2024年2月期第2四半期	148,807	90,113	55.7
2023年2月期	126,482	74,795	53.9

(参考) 自己資本 2024年2月期第2四半期 82,955百万円 2023年2月期 68,222百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年2月期	—	0 00	—	135 00	135 00
2024年2月期	—	0 00	—	—	—
2024年2月期（予想）	—	—	—	135 00	135 00

(注) 直前に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 2024年2月期の連結業績予想（2023年3月1日～2024年2月29日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	88,026	△6.9	21,619	△18.2	21,553	△29.0	15,718	△26.5	892 13

(注) 直前に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動：無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ー社 (社名) 、除外 ー社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)	2024年2月期2Q	17,640,000株	2023年2月期	17,640,000株
② 期末自己株式数	2024年2月期2Q	19,791株	2023年2月期	358,747株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	2024年2月期2Q	17,618,373株	2023年2月期2Q	17,281,305株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述について)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	5
四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報等)	7
3. 補足情報	8
生産、受注及び販売の状況	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調で推移しましたが、世界的なインフレ圧力に伴う各国中央銀行の金融引締め、中国経済の先行き懸念、米中半導体輸出規制の強化等により、先行き不透明な状況が継続いたしました。

当業界におきましては、中長期的には生成系AI、5G、IoTなどの情報通信技術の発展や、それに伴うデータセンターの能力拡張等、半導体市場の力強い成長が見込まれるとともに、世界各地では政府支援も背景とした半導体関連の工場建設の計画が進んでおります。一方、短期的にはメモリ半導体の世界的な半導体需要の減速に伴い、半導体メーカーによる一時的な在庫調整や設備投資の先送りの動きが見られました。

このような状況の中、当社グループにおきましては、当第1四半期連結会計期間では半導体メーカーの設備投資計画の先送り等の影響を受け、売上は低調に推移しました。しかし、当第2四半期連結会計期間に入り、主に中国向け及び米国向けにおいて需要が回復基調で推移しました。

この結果、当第2四半期連結累計期間における経営成績は、売上高40,992百万円（前年同期比10.4%減）、営業利益9,952百万円（前年同期比9.0%減）、経常利益は為替の影響も受け、13,878百万円（前年同期比17.9%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益9,835百万円（前年同期比20.5%減）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

半導体・FPD関連装置事業の売上高は40,839百万円（前年同期比10.4%減）、セグメント利益は10,297百万円（前年同期比9.5%減）となりました。

ライフサイエンス事業につきましては、売上高は152百万円（前年同期比17.6%減）、セグメント損失は97百万円（前年同期はセグメント損失88百万円）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ22,324百万円増加し、148,807百万円となりました。これは主に、棚卸資産の増加12,176百万円、現金及び預金の増加5,259百万円及びのれんの増加4,690百万円によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ7,006百万円増加し、58,693百万円となりました。これは主に、借入金の増加6,254百万円によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ15,317百万円増加し、90,113百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加7,502百万円及び為替換算調整勘定の増加3,402百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2024年2月期の通期連結業績予想につきましては、2023年4月11日公表の「2023年2月期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載しております予想数値に変更はありません。

なお、第2四半期連結累計期間における業績につきましては、本日（2023年10月11日）公表の「第2四半期連結累計期間の連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ」をご覧ください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年2月28日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	28,292	33,551
受取手形及び売掛金	26,722	24,594
商品及び製品	2,778	5,143
仕掛品	14,067	16,430
原材料及び貯蔵品	25,988	33,437
その他	2,150	2,167
貸倒引当金	△12	△26
流動資産合計	99,986	115,299
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	10,398	11,408
機械装置及び運搬具(純額)	6,209	6,315
土地	4,415	4,676
その他(純額)	1,079	837
有形固定資産合計	22,102	23,237
無形固定資産		
のれん	—	4,690
その他	643	663
無形固定資産合計	643	5,353
投資その他の資産		
投資有価証券	1,369	2,162
退職給付に係る資産	189	223
繰延税金資産	1,290	1,465
その他	954	1,123
貸倒引当金	△53	△59
投資その他の資産合計	3,749	4,916
固定資産合計	26,496	33,508
資産合計	126,482	148,807

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年2月28日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年8月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	7,350	5,864
短期借入金	14,936	16,058
未払法人税等	4,268	3,468
賞与引当金	1,021	982
役員賞与引当金	72	2
製品保証引当金	1,287	1,204
その他	4,107	6,743
流動負債合計	33,044	34,324
固定負債		
長期借入金	17,887	23,019
役員退職慰労引当金	306	416
退職給付に係る負債	67	68
資産除去債務	272	303
繰延税金負債	105	383
その他	3	178
固定負債合計	18,643	24,369
負債合計	51,687	58,693
純資産の部		
株主資本		
資本金	982	982
資本剰余金	1,470	5,231
利益剰余金	61,221	68,723
自己株式	△55	△3
株主資本合計	63,619	74,935
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	153	168
為替換算調整勘定	4,449	7,851
その他の包括利益累計額合計	4,602	8,020
新株予約権	85	85
非支配株主持分	6,487	7,072
純資産合計	74,795	90,113
負債純資産合計	126,482	148,807

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
売上高	45,753	40,992
売上原価	31,149	26,123
売上総利益	14,603	14,868
販売費及び一般管理費	3,671	4,916
営業利益	10,932	9,952
営業外収益		
受取利息	6	29
受取配当金	2	2
為替差益	6,212	3,924
売電収入	35	28
その他	75	212
営業外収益合計	6,333	4,197
営業外費用		
支払利息	23	37
売電費用	11	10
デリバティブ損失	313	199
その他	15	24
営業外費用合計	364	271
経常利益	16,901	13,878
特別利益		
固定資産売却益	12	2
特別利益合計	12	2
特別損失		
固定資産売却損	—	0
固定資産除却損	5	6
特別損失合計	5	6
税金等調整前四半期純利益	16,907	13,874
法人税、住民税及び事業税	3,974	3,552
法人税等調整額	△64	145
法人税等合計	3,910	3,697
四半期純利益	12,997	10,176
非支配株主に帰属する四半期純利益	630	341
親会社株主に帰属する四半期純利益	12,366	9,835

(四半期連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
四半期純利益	12,997	10,176
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△6	15
為替換算調整勘定	4,549	3,690
その他の包括利益合計	4,542	3,705
四半期包括利益	17,539	13,881
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	16,512	13,252
非支配株主に係る四半期包括利益	1,027	628

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当社は、2023年1月6日開催の取締役会決議に基づき、2023年3月2日付で、当社を株式交換完全親会社、株式会社イアスを株式交換完全子会社とする株式交換による自己株式338,976株の処分を行っております。この結果、第1四半期連結会計期間において資本剰余金が3,761百万円増加し、自己株式が52百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末において資本剰余金が5,231百万円、自己株式が3百万円となっております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第2四半期連結累計期間(自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期 連結財務諸表 計上額(注) 2
	半導体・ FPD関連 装置事業	ライフ サイエンス 事業	計		
売上高					
日本	4,705	99	4,805	—	4,805
台湾	6,598	—	6,598	—	6,598
中国	9,467	53	9,520	—	9,520
韓国	3,981	—	3,981	—	3,981
米国	12,024	0	12,024	—	12,024
その他	4,062	—	4,062	—	4,062
顧客との契約から生 じる収益	40,839	152	40,992	—	40,992
外部顧客への売上高	40,839	152	40,992	—	40,992
セグメント間の内部 売上高又は振替高	3	—	3	△3	—
計	40,843	152	40,995	△3	40,992
セグメント利益 又は損失(△)	10,297	△97	10,200	△247	9,952

(注) 1. セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用△247百万円であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当第2四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごと及び品目別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	品目	生産高（百万円）	前年同期比（％）
	半導体関連装置	24,473	89.9
	FPD関連装置	1,218	35.9
	モータ制御機器	47	94.1
	計	25,739	83.9
ライフサイエンス事業		82	63.2
合計		25,822	83.8

(注) 1. 金額は、製造原価によっております。

(2) 受注実績

当第2四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごと及び品目別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	品目	受注高（百万円）	前年同期比（％）	受注残高（百万円）	前年同期比（％）
	半導体関連装置	32,617	58.4	54,008	83.6
	分析装置	1,318	—	4,485	—
	FPD関連装置	6,063	482.2	5,053	386.6
	計	39,998	70.0	63,546	96.4
ライフサイエンス事業		438	57.3	627	75.0
合計		40,437	69.8	64,174	96.2

(注) 1. 金額は、販売価格によっております。

(3) 販売実績

当第2四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごと及び品目別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 品目	販売高（百万円）	前年同期比（%）
半導体関連装置	34,477	88.5
分析装置	1,521	—
FPD関連装置	1,715	43.9
モータ制御機器	87	123.5
部品・修理 他	3,038	115.7
計	40,839	89.6
ライフサイエンス事業	152	82.4
合計	40,992	89.6

(注) 1. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先	前第2四半期連結累計期間		当第2四半期連結累計期間	
	販売高 (百万円)	割合（%）	販売高 (百万円)	割合（%）
Applied Materials, Inc.	8,954	19.6	9,831	24.0
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.	4,911	10.7	—	—

(注) 1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. に対する当第2四半期連結累計期間の売上高は、3,483百万円（総販売実績に対する割合8.5%）であります。